

代表的な封止材のエポキシ樹脂配合例

組成		半導体封止	LED封止
エポキシ樹脂	基本樹脂	0-クレゾールノボラック型、 ビフェニル型、多官能型 ジシクロペンタジエン型、 ビフェニルアラルキル型 他	ビスフェノールA型、脂環型、 ビスフェノールF型、
	難燃樹脂	臭素化ビスフェノールA型、 臭素化フェノールノボラック型	—
	可撓性樹脂	シリコーン	—
硬化剤	ノボラック型フェノール樹脂 (ビフェニルアラルキル型など)	脂環型酸無水物 (MHHPAなど)	
硬化促進剤	イミダゾール、リン系促進剤、 DBU系促進剤	3級アミン、 リン系促進剤、DBU系促進剤	
充填剤	シリカ	光分散剤(シリカなど)	
難燃剤	三酸化アンチモン	—	
その他	離型剤、シランカップリング剤、 カーボンブラック(着色剤) イオン補足剤	有機染料、	
主な要求特性	耐熱性、耐湿性(耐PCT性) 耐ヒートクラック性、電気特性	耐湿性、耐ヒートクラック性、 光透過性	